

関係各位

レンゴー株式会社
広報部

TOKYO PACK 2026 ―2026 東京国際包装展― に出展します

レンゴー株式会社は、TOKYO PACK 2026 ―2026 東京国際包装展― に出展いたします。

当社ブースは「パッケージに新たな価値を」をテーマに、レンゴーグループの環境推進への取組みをはじめ、販促や物流の分野で新たな価値創造のヒントとなる製品・ソリューションのかずかずをご紹介します。

少ない資源で大きな価値を生む「Less is more.」をキーワードに、包装の新たな価値を創造し続ける「ゼネラル・パッケージング・インダストリー」=G P I レンゴーの最新の姿をぜひともご高覧賜りますようご案内申し上げます。



<TOKYO PACK 2026 開催概要>

会 期 2026年10月14日（水）～16日（金） 10:00～17:00
会 場 東京ビッグサイト（東京国際展示場） 東1～3、7、8ホール
テーマ 包みの技術で 世界に優しさを
主 催 公益社団法人日本包装技術協会（J P I）
入 場 無料（入場にはご登録が必要です）

（1／2）

<当社関連の出展／展示ブース>

- レンゴーブース 東1ホール 1R18
- 2026 グッドパッケージング展、木下賞受賞作品展では、日本パッケージング
コンテスト入賞作品 12 点、木下賞入賞作品 1 点が展示 東7ホール右奥

<当社展示 特設サイト>

[レンゴー東京パック 2026 サイト](#)

以上

(2 / 2)